

檔 號：

保存年限：

財團法人國家實驗研究院 函

機關地址：300091新竹市科學園區展業一路26號

聯絡人：羅愛雁

電話：03-5773693分機7769

電子信箱：0508364@niar.org.tw

受文者：國立聯合大學

發文日期：中華民國115年10月28日

發文字號：國研授半導體企字第1151301511號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件一徵案公告(attch1 ec0aa812fbel093620829a20910860d_1151301511-0-0.pdf)

主旨：本院台灣半導體研究中心「116年台灣半導體研究中心與布拉格捷克理工大學聯合研究中心 (TSRI-CTU Joint Research Center) 徵案計畫」，自公告日起至11月27日受理申請，請惠予轉知貴校半導體相關系所院研究團隊踴躍申請，請查照。

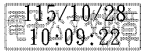
說明：

- 一、為促進台捷雙方合作交流，台灣半導體研究中心(TSRI)與布拉格捷克理工大學(Czech Technical University in Prague, CTU)自114年起成立聯合研究中心並推動雙邊研究合作計畫，迄今已展現良好成效。為延續合作基礎並深化雙方交流，今年續辦並徵求116年度雙邊研究合作計畫。
- 二、旨揭計畫之執行期程自116年1月1日至116年11月19日。
- 三、有關申請資格、補助經費、申請方式、審查標準、重要時程及其他注意事項等，請詳附件徵求公告，或參考本中心官網之最新消息：https://www.tsri.org.tw/tw/infoopen/infoOpenCommon_detail.jsp?newsId=2026102003&kindName=Activities&kindId=I0002，敬請申請機構及計畫

主持人先行詳閱各項規定。

四、相關計畫內容疑問，請洽：03-5773693 #7779 (葉先生)

正本：半導體相關大專院校

副本：

院長 蔡宏營

裝



訂

線



台灣半導體研究中心與布拉格捷克理工大學聯合研究中心

(TSRI-CTU Joint Research Center)徵案計畫

2026.10

本中心(TSRI)與布拉格捷克理工大學(Czech Technical University in Prague, CTU)自2025年起成立聯合研究中心並推動雙邊研究合作計畫，迄今已展現良好成效。為延續合作基礎並深化雙方交流，今年決議續辦並徵求2027年度的雙邊研究合作計畫。

本徵案計畫旨在透過學術合作與本中心服務平台，建立團隊間長期穩定的夥伴關係，並促進雙邊科研資源與優勢共享。本案以台方計畫主持人為申請者，依本中心公布辦法與相關文件進行研究計畫案申請，其餘說明如下：

一、計畫收件時間：自公告日起至2026年11月27日(五)23:59(GMT+8)

二、計畫期程：為配合雙方內部作業流程，將於2026年12月30日確認審查獲選名單，入選團隊將會進行限制性招標，計畫期程自決標日起，於2027年7月2日前繳交期中查驗報告，並於2027年11月19日前繳交期末驗收報告，計畫截止日為2027年11月19日。

三、線上說明會：

本中心將於線上說明會中說明及回覆徵案相關常見問題，並邀請有意參與徵案之教授或其研究團隊所推派的研究生，於會中簡短介紹研究主題，相關說明如下：

1. 線上說明會時間：2026年11月5日(四) 16:00-18:00 (GMT+8)
2. 線上說明會報名期間：即日起至2026年11月3日(二) 23:59 (GMT+8)
3. 線上說明會報名連結：[Online Information Session](#)
4. 線上說明會檔案上傳方式：請有意於線上說明會簡要介紹研究主題的教授或研究生，透過 [Slides Upload](#) 連結上傳約一至兩分鐘的投影片檔案。

四、徵案條件：

1. 執行對象：

徵案團隊須由台方大專校院教授及CTU教授各一位共同擔任計畫主持人(PI)，雙邊共同執行同一計畫主題，並由台方計畫主持人於期限內提交研究計畫申請書，以進行後續評選。

2. 研究主題領域：

- 1) 晶片設計領域：Analog Design, Digital Design, MEMS Sensors, Silicon Photonics_及其他設計領域相關主題

- 2) 晶片製造領域：Semiconductor Manufacturing Technology, Technology Computer-Aided Design (TCAD)及其他製造領域相關主題

3. 研究團隊媒合：

- 1) 請有意參與研究的團隊進入下方連結進行研究主題與聯絡資訊的填寫，以利雙邊團隊媒合：[Matching List](#)
- 2) 請有意參與研究的團隊進入下方連結上傳研究領域介紹投影片檔案，以利雙邊團隊媒合：[Slides Upload](#) (進入[Matching Folder](#)可檢視已上傳的檔案)



4. 對於入選的徵案團隊，雙邊團隊之間可能需要簽訂協議，例如 CRA (Collaborative Research Agreement)。該協議可能明訂雙方權利義務分配等項目，包括有關智慧財產權的條款，協議內容將由雙邊研究團隊自行商定。

5. 依據政府採購法利益迴避原則，計畫申請人應避免擔任此計畫之評審委員。

五、計畫補助：

1. 每件計畫補助研究經費最高新臺幣壹佰玖拾萬元，將以分批付款方式給付，確認獲選後付款50%，通過期中查驗付款40%，最終通過期末結案驗收付款10%。
2. 依計畫申請書之晶片下線需求規劃(如有)，TSRI將配合研究計畫實際執行進度補助每案最高新台幣壹佰肆拾貳萬元整之TSRI晶片下線額度，以支持研究團隊進行晶片實作發表。

六、申請方式與時間：

請備齊雙邊共同以英文撰寫之研究計畫申請書(附件一，Word 檔)及相關補充資料，於收件截止日期(台灣時間2026年11月27日23:59)前寄送至 tsri.ctu_jrc@niar.org.tw，將以信件寄出時間為憑，逾期概不受理。計畫申請書於送件後即不得修改及增訂，評審完畢後亦不予退回。

- 七、評定辦法：符合徵案資格且在期限內提供申請文件者，將依照雙邊連結性(30%)、實現可行性(25%)、技術前瞻創新性(20%)、延伸合作潛力(15%)及預算規畫合理性(10%)等項目進行計劃內容及預算的評比，評選結果將於12月30日通知獲選團隊。如未通過審查，原計畫書文件將不會退還申請人。



八、計畫期程與查驗時間點：

計畫執行期間為限制性招標決標後起始，至2027年11月19日為計畫截止日。此計劃共包含兩次查驗，分為期中查驗及期末結案驗收。

1. 期中查核點：於2027年7月2日前提交期中進度執行報告書及計畫時程進度檢核表，期中進度執行報告書內容應包含目前實際執行計畫內容、已完成之工作項目、延伸計畫執行規劃及未完成事項之期程等，並至少完成1項執行績效量化指標。
2. 期末結案查核：於2027年11月19日前完成研究計畫書內之規劃項目並提交期末結案報告書及計畫時程進度檢核表，期末結案報告內容包含雙邊研究報告說明、雙邊短期交流紀錄與心得，以及學術論文、專利申請和延伸計畫證明等執行績效成果說明。

九、注意事項：

1. 研究計畫申請書的結構如下：

- 1) 基本資料 (計畫主題與分類、雙邊團隊主持人及聯繫窗口資訊)
 - 2) 團隊成員 (雙邊團隊協作人員學歷、職掌與分工)
 - 3) 計畫摘要
 - 4) 計畫內容 (計畫背景、技術優勢、研究實施策略、預期成果及國際研究合作之價值貢獻等)
 - 5) 計畫時程規劃 (工作時程控管、查核點說明、預計完成項目及績效項目說明)
 - 6) 預算規劃
 - 7) 雙邊聲明與簽名
 - 8) 附件
2. 此計畫研究經費的使用需建立清冊，可提供期末結案查核時備查。
3. 重要作業時程：

申請截止日期	2026年11月27日(五)
公告獲選名單	2026年12月30日(三)
計畫起始日	2027年1月1日(五) (若決標日晚於1月1日，則以決標日為計畫起始日)
期中查驗	2027年7月2日(五)前提供查驗報告
期末驗收	2027年11月19日(五)前提供結案報告

十、聯繫窗口：

聯絡電話：03-5773693 #7779 (葉先生)

E-mail：tsri.ctu_jrc@niar.org.tw

